



平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年1月31日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役 専務執行役員 (氏名) 堀 哲朗

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成29年2月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第3四半期	539,087	7.9	94,160	8.5	95,692	8.7	67,918	14.7
28年3月期第3四半期	499,722	15.9	86,763	66.2	88,039	55.1	59,235	58.1

(注) 包括利益 29年3月期第3四半期 68,563百万円 (25.9%) 28年3月期第3四半期 54,461百万円 (18.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第3四半期	414.01	412.90
28年3月期第3四半期	347.30	346.42

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年3月期第3四半期	885,786	594,566	66.8
28年3月期	793,367	564,239	70.9

(参考) 自己資本 29年3月期第3四半期 591,636百万円 28年3月期 562,369百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	125.00	—	112.00	237.00
29年3月期	—	128.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	177.00	305.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	762,000	14.8	140,000	19.9	142,000	18.9	100,000	28.4	609.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年3月期3Q	165,210,911 株	28年3月期	165,210,911 株
29年3月期3Q	1,146,591 株	28年3月期	1,176,800 株
29年3月期3Q	164,049,252 株	28年3月期3Q	170,561,309 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成29年1月31日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	9
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(四半期連結損益計算書関係)	11
(セグメント情報等)	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間につきましては、米国の景気が緩やかに拡大し、中国においては景気持ち直しの兆しが見られます。また、日本においても景気回復基調にあり、世界経済全体は緩やかに回復しています。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、好調なデータセンター向けサーバー需要やスマートフォンの高機能化を背景に、半導体・電子部品の需要は堅調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高5,390億8千7百万円(前年同期比7.9%増)、営業利益941億6千万円(前年同期比8.5%増)、経常利益956億9千2百万円(前年同期比8.7%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は679億1千8百万円(前年同期比14.7%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

クラウドコンピューティングの発展に伴うサーバーの高性能化や、モバイル機器におけるデータ処理の高機能化と大容量化を背景に、ロジック系半導体メーカーによる先端技術及び3次元構造のNANDフラッシュメモリー向けの投資が引き続き活発に行われており、半導体製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、5,063億8千2百万円(前年同期比9.2%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

FPD製造装置市場では、モバイル端末用の中小型液晶パネル向けなどの設備投資が続きました。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、323億6千7百万円(前年同期比7.9%増)となりました。

③ その他

当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、3億3千7百万円(前年同期比94.6%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
売上高	147,976	204,745	186,364	539,087
半導体製造装置	130,796	196,211	179,373	506,382
日本	17,819	26,429	20,329	64,578
米国	17,022	34,416	24,634	76,074
欧州	5,234	6,695	15,061	26,991
韓国	19,805	29,031	33,376	82,213
台湾	30,504	58,289	62,360	151,155
中国	30,049	24,044	13,798	67,892
東南アジア他	10,360	17,304	9,812	37,476
F P D製造装置	17,064	8,414	6,887	32,367
その他	115	119	103	337
営業利益	22,095	37,916	34,147	94,160
経常利益	24,083	38,281	33,327	95,692
親会社株主に帰属する 四半期純利益	12,684	29,281	25,951	67,918

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	140,236	203,496	174,941	518,674
F P D製造装置	9,623	6,832	13,271	29,727
その他	-	-	-	-
合計	149,860	210,328	188,213	548,402

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
半導体製造装置	197,496	195,695	267,187	660,380
F P D製造装置	15,955	15,032	30,484	61,472
その他	111	119	115	346
合計	213,564	210,848	297,787	722,199

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位: 百万円)

	当期		
	第1Q末	第2Q末	第3Q末
半導体製造装置	329,988	329,473	417,286
F P D製造装置	36,319	42,937	66,533
その他	1	0	13
合 計	366,309	372,411	483,833

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ929億1千4百万円増加し、7,103億3千万円となりました。主な内容は、現金及び預金の増加391億1千8百万円、たな卸資産の増加352億4千4百万円、受取手形及び売掛金の増加96億8千6百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から21億8千万円増加し、984億9千7百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から8億4千7百万円減少し、167億5千6百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から18億2千9百万円減少し、602億2百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から924億1千8百万円増加し、8,857億8千6百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ612億1千万円増加し、2,272億7千1百万円となりました。主として、前受金の増加575億9千5百万円、支払手形及び買掛金の増加62億3千万円、未払法人税等の減少73億4千7百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ8億8千1百万円増加し、639億4千9百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ303億2千6百万円増加し、5,945億6千6百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益679億1千8百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当及び当期の中間配当393億7千1百万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は66.8%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ546億5千4百万円増加し、1,502億9千3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,270億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ406億1千9百万円増加し、2,772億9千3百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ318億7千万円増加の933億1千万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益876億3千2百万円、減価償却費127億7千9百万円、前受金の増加563億5千万円、仕入債務の増加54億2千8百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加354億5千8百万円、法人税等の支払額327億3千5百万円、売上債権の増加97億2千3百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入140億3千2百万円、有形固定資産の取得による支出125億4千8百万円により、前年同期の1,140億8千4百万円の支出に対し4千3百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払393億7千1百万円により、前年同期の1,385億9千8百万円の支出に対し393億7千8百万円の支出となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,439	93,310
税金等調整前四半期純利益	82,657	87,632
減価償却費	14,279	12,779
売上債権の増減額(△は増加)	7,100	△9,723
たな卸資産の増減額(△は増加)	△9,686	△35,458
仕入債務の増減額(△は減少)	△10,107	5,428
その他	△22,803	32,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,084	43
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△107,987	14,032
その他(固定資産の取得等)	△6,097	△13,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	△138,598	△39,378
現金及び現金同等物に係る換算差額	△617	679
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△191,861	54,654
現金及び現金同等物の期首残高	317,632	95,638
現金及び現金同等物の四半期末残高	125,770	150,293
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	233,809	277,293

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の連結業績予想につきましては、前回発表時(平成28年10月28日)の見通しを変えておりません。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第 32 号 平成 28 年 6 月 17 日)を第 1 四半期連結会計期間に適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	75,674	114,793
受取手形及び売掛金	116,503	126,189
有価証券	160,999	162,500
商品及び製品	130,478	149,702
仕掛品	41,556	51,157
原材料及び貯蔵品	23,044	29,464
その他	69,207	76,584
貸倒引当金	△48	△61
流動資産合計	617,416	710,330
固定資産		
有形固定資産	96,316	98,497
無形固定資産		
その他	17,603	16,756
無形固定資産合計	17,603	16,756
投資その他の資産		
その他	63,857	62,035
貸倒引当金	△1,825	△1,832
投資その他の資産合計	62,031	60,202
固定資産合計	175,951	175,456
資産合計	793,367	885,786
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	55,050	61,280
未払法人税等	22,460	15,112
前受金	33,522	91,118
その他の引当金	21,731	17,491
その他	33,295	42,267
流動負債合計	166,060	227,271
固定負債		
その他の引当金	374	374
退職給付に係る負債	55,302	56,643
その他	7,390	6,930
固定負債合計	63,067	63,949
負債合計	229,128	291,220

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	427,618	456,080
自己株式	△8,050	△7,844
株主資本合計	552,551	581,220
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,902	8,551
繰延ヘッジ損益	50	△106
為替換算調整勘定	6,742	6,620
退職給付に係る調整累計額	△4,877	△4,648
その他の包括利益累計額合計	9,817	10,416
新株予約権	1,641	2,654
非支配株主持分	228	275
純資産合計	564,239	594,566
負債純資産合計	793,367	885,786

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
売上高	499,722	539,087
売上原価	301,640	327,468
売上総利益	198,082	211,619
販売費及び一般管理費		
研究開発費	55,931	58,977
その他	55,386	58,481
販売費及び一般管理費合計	111,318	117,458
営業利益	86,763	94,160
営業外収益		
その他	2,301	2,083
営業外収益合計	2,301	2,083
営業外費用		
為替差損	7	351
自己株式取得費用	662	-
その他	356	200
営業外費用合計	1,025	551
経常利益	88,039	95,692
特別利益		
固定資産売却益	1,010	50
その他	-	6
特別利益合計	1,010	57
特別損失		
減損損失	4,434	-
災害による損失	-	7,828
その他	1,958	288
特別損失合計	6,393	8,116
税金等調整前四半期純利益	82,657	87,632
法人税等	23,392	19,678
四半期純利益	59,264	67,953
非支配株主に帰属する四半期純利益	29	35
親会社株主に帰属する四半期純利益	59,235	67,918

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
四半期純利益	59,264	67,953
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,193	643
繰延ヘッジ損益	△146	△57
為替換算調整勘定	△2,211	△128
退職給付に係る調整額	△1,224	189
持分法適用会社に対する持分相当額	△26	△36
その他の包括利益合計	△4,802	609
四半期包括利益	54,461	68,563
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	54,442	68,516
非支配株主に係る四半期包括利益	19	47

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

災害による損失

平成 28 年熊本地震の影響による、建物、生産・開発設備等の原状回復及び在庫の廃棄等に係る実績及び現時点での見積費用であります。

法人税等

過年度における当社と米国子会社との間の移転価格税制に基づく更正処分について、日米両国の税務当局間の相互協議が合意に向けて進展し、二重課税が解消される見込みとなりました。これに伴い想定される還付額と、過年度において計上していた還付見込額との差額△405 百万円を、当第 3 四半期連結累計期間の「法人税等」に含めて表示しております。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	506,382	32,367	10,555	549,305	△10,217	539,087
セグメント利益	115,083	2,219	98	117,401	△29,768	87,632

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、PV(太陽光パネル)製造装置事業及び当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。
2. セグメント利益の調整額△29,768百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△12,129百万円及び、災害による損失△7,828百万円等であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。